

2023年12月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

2023年11月14日

上場会社名 ウィンテスト株式会社

上場取引所 東

コード番号 6721 URL <https://www.wintest.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 姜 輝

問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役

(氏名) 樋口 真康

TEL 045-317-7888

四半期報告書提出予定日 2023年11月14日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2023年12月期第3四半期の連結業績(2023年1月1日~2023年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年12月期第3四半期	263	89.8	374		352		354	
2022年12月期第3四半期	138	39.3	513		486		488	

(注) 包括利益 2023年12月期第3四半期 310百万円 (%) 2022年12月期第3四半期 411百万円 (%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2023年12月期第3四半期	9.12	
2022年12月期第3四半期	14.29	

(注) 2023年12月期第3四半期及び2022年12月期第3四半期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2023年12月期第3四半期	1,789	1,475	81.9
2022年12月期	1,902	1,352	70.6

(参考) 自己資本 2023年12月期第3四半期 1,465百万円 2022年12月期 1,343百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2022年12月期		0.00		0.00	0.00
2023年12月期		0.00			
2023年12月期(予想)				0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2023年12月期の連結業績予想(2023年1月1日~2023年12月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	522	148.3	465		435		468		12.44

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

連結業績予想の修正については、本日(2023年11月14日)公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- | | |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 有 |
| 以外の会計方針の変更 | : 無 |
| 会計上の見積りの変更 | : 無 |
| 修正再表示 | : 無 |

(注)詳細は、添付資料P.12「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」をご覧ください

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2023年12月期3Q	39,972,000 株	2022年12月期	36,072,000 株
期末自己株式数	2023年12月期3Q	株	2022年12月期	株
期中平均株式数(四半期累計)	2023年12月期3Q	38,812,864 株	2022年12月期3Q	34,166,518 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますことをご確認ください。

また、上記予想の前提条件、その他関連する事項については、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(1) 経営成績に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	8
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	12
(会計方針の変更)	12
(セグメント情報等)	12
(重要な後発事象)	13
3. その他	14
継続企業の前提に関する重要事象等	14

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間（2023年1月1日～2023年9月30日）における世界半導体市場は、新型コロナウイルス禍が猛威を奮った2020年から2022年に起きた、急激なテレワーク需要に端を発するPC、スマホ等のIT機器向けパネル及び半導体チップの急激な需要増とアフターコロナに伴う急峻な半導体需要減を原因とする民生半導体部材の過剰在庫が長期化し、半導体各製造工場は新規投資を見合わせる状況となりました。半導体の生産調整は、JEITA半導体部会や世界半導体市場統計(WSTS)によると、2023年上半期には終息するとの予測を立てておりましたが、当第3四半期末現在においては、明るい兆しを見せながらも引き続き半導体各社の新規設備投資は慎重な姿勢を崩していない状況です。足元では最近の台湾情勢を取巻く米中関係、長引くウクライナ侵攻の影響、加えてイスラエルのガザ問題は、世界大戦への懸念が叫ばれ、世界情勢は予断を許さない状況です。また、国内においては、大幅な円安による物価上昇圧力が続き消費者マインドにも影響が出ており、それは市場、経済ともにマイナス要因に働くことが予想されております。しかしながら、米国半導体工業会（SIA）では、2023年後半では米州や欧州・中国・日本などの主要市場において、それぞれ前月比プラスに転じており、当第3四半期以降は、1年近く続いた世界的な半導体市場の縮小に、ようやく底打ち感が見られると報告されております。そして2024年は、日本のみならず、世界規模で官民入り乱れた半導体工場の投資合戦が起こるともいわれ、矢継ぎ早に半導体事業の拡大戦略が打ち出されております。「産業のコメ」から「戦略物資」と化した半導体市場は、今後中期的に大きく回復方向へと向かうと予想されております。

当社グループが属する半導体並びにフラットパネルディスプレイ業界は、テレワーク等に支えられてきた2021年から2022年前半までは好調でしたが、大量消費国であった中国各地におけるロックダウン政策の影響を受けて、2022年後半は大きく減退し、パネル各社は在庫調整に入っております。しかし当該市場の今後は、各国政府の進めるDX（デジタルトランスフォーメーション）のさらなる進展や脱炭素化推進に向けた取り組み、自動運転や5G、6Gなどの高速通信環境がもたらす新しい世界（VRやメタバース）が急速に開発・開拓され、広範な需要に支えられ、足元も含めた半導体サイクルといわれる短期需要変動を繰り返しつつも、中長期的に大きな成長が予測されております。

このような環境下、2023年度における当社グループの主要事業である半導体検査装置事業分野では、国際半導体製造装置協会（SEMI）によると、同装置市場における規模は、過去最高であった2022年の1,074億ドルから半導体の需要低迷による新規設備投資の抑制が長引いたことによる大幅な下方修正を背景として、2023年は18.6%減の874億ドルに縮小となる見通しで、PCやスマホ向け半導体を製造する韓国サムスン電子や米マイクロン・テクノロジーも大幅な生産調整による減産を行っており、特にメモリーやロジック分野の装置売上高は28%減、市場を引っ張ってきたNAND分野も51%減の見通しです。2024年は、前工程と後工程の両分野の成長によってけん引され、1,000億ドルを回復すると予想され、生成人工知能（AI）向けのデータセンターの拡大や電気自動車（EV）、仮想現実（VR）端末の普及、つまりハイパフォーマンス・コンピューティングとユビキタス・コネクティビティに牽引された旺盛な成長が今後長期的に見込まれることにより、需要回復が期待されます。当社としては、市場の上昇機運は未だ弱いものの、より高速高精度な半導体、特に高画素化が求められているLCDドライバICに注力し、引き続きお客様のニーズを取り込んだ既存装置の改良改善、そして次世代デバイス向け検査装置の開発を継続することで、2023年下半年から2024年にかけて回復が予想される当該市場に注力してまいります。

当第3四半期連結累計期間においては、上述のように、お客様工場の生産調整による新規設備投資の抑制が長期化したことから、期待していた受注に遅れが発生し、売上は低迷いたしました。営業面では、販売店に集中させていた販売方法を、中国市場新戦略として9月初旬より大きく見直し、当社の製造子会社の営業を含めた直接の販売を拡大を図り、現地マーケットに集中した営業展開を本格化いたしました。

この結果、当第3四半期連結累計期間の当社グループの売上高は263,602千円（前年同四半期比89.8%増）、営業損失374,833千円（前年同四半期は営業損失513,881千円）、経常損失352,193千円（前年同四半期は経常損失486,356千円）、親会社株主に帰属する四半期純損失354,051千円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失488,214千円）となりました。

なお、セグメント区分については、従来報告セグメントの「半導体検査装置事業」及び報告セグメントに含まない「その他」の2つにセグメントを区分しておりましたが、第1四半期連結会計期間より「半導体検査装置事業」の単一セグメントに変更しております。

これは、「その他」の事業セグメントに含まれておりましたオーディオ事業を2022年8月末付にて、株式会社データゲート（大阪府大阪市北区）に事業譲渡を行ったことにより、「その他」に含まれていた事業がなくなったためであり、報告セグメントを「半導体検査装置事業」の単一セグメントとして管理することが適切と判断したためであります。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第3四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ112,769千円減少し、1,764,531千円(前連結会計年度末比6.0%減)となりました。この主な要因は、現金及び預金が150,860千円減少したことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ190千円減少し、24,752千円(前連結会計年度末比0.8%減)となりました。この主な要因は、投資その他の資産のその他が190千円減少したことによるものです。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べ211,328千円減少し、162,405千円(前連結会計年度末比56.6%減)となりました。この主な要因は、短期借入金が157,030千円減少したことによるものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ24,105千円減少し、151,686千円(前連結会計年度末比13.7%減)となりました。この主な要因は、長期借入金が24,048千円減少したことによるものです。

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末に比べ122,474千円増加し、1,475,192千円(前連結会計年度末比9.0%増)となりました。この主な要因は、資本金及び資本準備金がそれぞれ216,669千円増加したものの、利益剰余金が354,051千円減少したことによるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

上述いたしましたように2022年8月から顕在化していた民生向け半導体の在庫調整も2023年上半期中には一段落するものと予測されておりましたが、当第3四半期末現在においても、各社半導体在庫は適正とされる3か月を上回る在庫があり、各半導体製造工場の在庫抑制を目的とした生産調整がなされ新規設備投資は思わしくありません。特に民生機器の一部である、スマートフォンやPC、そしてIT情報端末機器などの半導体製品にだぶつき感が発生し、各半導体工場における在庫抑制を目的とした生産調整が続いております。しかしながら、半導体のデザインハウス及び大手OSAT(半導体の検査、組立を受託する専門工場)を中心に工場の稼働率は回復の兆しが見えており、当社においても、当第3四半期連結会計期間にてデザインハウス、OSATからそれぞれ受注を頂きました。

WSTS(世界半導体市場統計)の調査では、半導体製造各社による在庫調整プロセスは、確実に進行しているとされ、その調整プロセスは、2023年半ばから徐々に解消に向かい2024年前半にかけて終了、増産に向かうとの見通しが主流となっていると報告されております。他方、半導体の種類や用途、テクノロジーノード(technology node、半導体製造プロセスとその設計ルールのことを言います。)により、一部の半導体では需給の逼迫が継続しており、市場の二極化が見られる一面もあります。そのため、製造各社における新規設備投資は、出口を見据えながら慎重な姿勢を崩しておりませんが、確実に過剰在庫は減っており、第4四半期以降は徐々に回復してくるものと考えております。また2024年を含む中長期的には、ChatGPTに代表される生成人工知能A.I.サーバー投資や、自動車の電動化の進展及び5G関連産業への投資需要が強く見込まれており、市場は力強く成長するものと見られております(「Electronic Engineering Times」より)。

また、近年の半導体の複雑化や集積度向上(例、線幅4nmから2nm)は半導体の機能の増加を意味し、検査時間の伸長に繋がります。しかしながら、同時に量産性も要求されるため、半導体検査市場は、装置能力の向上に加えて装置台数の増加が期待されるであろうと考えられております。

当社グループが「主力装置」と位置付けるLCDドライバIC検査装置は、スマートフォンやPC等の情報端末の液晶パネルの駆動に使われる「ディスプレイドライバーIC」の検査に使用されております。また、それら情報端末には、「CMOSイメージセンサーIC」、「ロジックIC」など多種に渡る周辺半導体デバイスが使われております。現状足元では、上記のように半導体市場の足踏み状態が続いておりますが、中長期的には需要も戻り、大きな伸びが期待される分野です。

上述のような理由から当第3四半期連結会計期間中での売上は低迷致しましたが、当社の主力検査装置「WTS-577SR」につきましては、当第3四半期連結会計期間において、新たに3社から新デバイス向けベンチマークの承認をいただくことができました。加えて当社の主力検査装置「WTS-577SR」につきましては、開発中である「WTS-577SX」のハイエンドリソースの一部の開発済みリソースをとりこむことで、日々進化する新デバイスに向けた検査の提供をお客様に行うことが可能となり、また同時にお客様の量産ラインでの高い評価をいただくことができました。

第4四半期以降の半導体市場は、上述した世界半導体市場統計(WSTS)や日本貿易振興機構(JETRO)等の予想では、民生向け半導体(スマートフォン、PC向け半導体等)を中心として、生産調整は、出口が見える状況にあり、市況においても2024年にかけて徐々に回復すると報告されております。当社では、当第3四半期末現在においてもいまだ不足が叫ばれる産業用高速半導体を先行手配し、今期、来期における急な出荷要請にも耐え得る体制を準備しております。

新しい挑戦として、2023年9月より中国における営業戦略を見なおし、今まで代理店営業に頼っていた体制から直接営業を中心とした営業体制への変更を実施し、第4四半期から翌期に向けて営業活動を進めてまいりま

す。営業体制の見直しを受けて、当社の中国製造子会社「偉恩測試技術（武漢）有限公司」（以下、「ウインテスト武漢」という。）は、営業人事再編並びに顧客アクセスなどの向上を目的として、事務所を蘇州に移転しました。

また、中国市場新戦略として、当社親会社「武漢精測電子集団有限公司」グループの子会社で、同じく半導体検査装置関連の事業を営む「上海精積微半導体技術有限公司」と、営業・技術方面で協力体制を取るべく準備を進めております。

ウインテスト武漢におきましては、大阪事業所とともにQA（品質保証）の体制を見直し、最終組立工程の製造品質の向上に取り組み、中国国内市場での信頼構築と市場への深耕を図ってまいります。

先端ロジックI/O（820Mbps）を搭載する検査装置に関しては、第1四半期に前倒しで一部機能のリリースを行い、第2四半期に新リソースを搭載したWTS-577SRを出荷、その他の新リソースは、引き続き開発を継続しております。

次世代向け機能としてロジックパターンスピードが1,600Mbpsとなる高速リソースについて、第4四半期中に開発を終了する計画といたしておりましたが、先端ドライバICなどの一部部材の入荷遅れなどを原因として、評価が伸びております。これら開発中（一部完了）の新リソースをフルに積んだ、「WTS-577SX」のお客様への提供は、社内での最終評価の終了次第、遅くとも2024年第1四半期となる予定です。更に次世代のフラッグシップ検査装置である「WTS-9000S」の開発に関しては、2024年8月に完成、リリースする計画であり、国内、台湾、中国顧客向けを想定した機能やGUIの開発を継続しており、搭載するソフトウェア環境などの使い勝手の向上も視野に入れ、市場への早期リリースができるように計画しております。

また、新たな収益の柱を構築するための成長戦略として、当社グループがこれまで培ってきた検査技術や画像処理技術、高精度センサー技術、データ解析技術を応用し、且つ、当社及びウインテスト武漢の技術陣に加え、現地有力企業より営業方面・技術方面での協力体制を構築する予定です。それにより、2025年までに、今後市場拡大が見込まれるシステムオンチップ(SoC)市場や汎用デジタル市場等の検査分野、そしてM&Aも計画し、日本市場においても注目を集めるパワーデバイス検査分野への進出を目指し、この度あらたにパワーデバイス検査装置メーカーとパワーリソース開発などで協力体制取ることとなり、新規市場への参入、対応可能検査範囲の拡充と展開を行い、収益基盤の拡充に取り組んでまいります。

検査装置向け工場FA化機器技術（「自重補償機構技術」）については、学校法人慶應義塾大学慶應義塾先端科学技術研究センターと共同開発を進めており、特許等の申請については、既にお知らせのとおり手続きは終了しております。当該技術は当社の検査装置とウエーハ搬送装置との間のドッキングアダプター（以下「ポゴタワー」という。）の着脱（約25kg～30kg）をオペレーター一人で簡単に安全に行うための補助アーム（以下「マニピュレーター」という。）です。当面の目標として、その搬送可能重量を50kg前後で製品化を行います。現在は、製品の製造準備に取り掛かっており、先端ロボット等の開発製造をロボット等製造専門事業者様と協議を開始いたしました。また当該技術は、「半導体製造工場内FA化システム」、「物流搬送システム」並びに「介護等」への応用が可能と考えております。

奈良県立大学と進めております脈波（BCG, ECG）を利用したヘルスケア管理システムは、同大学並びに株式会社TAOS研究所とアライアンスを組み、製品化を行いました。2023年3月9日に開示しました「IoTセンサーを活用したセルフヘルスケア機器の販売開始決定及び価格に関するお知らせ」に記載いたしましたとおり、2023年4月1日より一部のお客様を中心に試験販売を開始いたしました。なお、当該製品の製造に関しましては当社大阪事業所で製造を行っており、2023年9月から製造を開始、順次市場投入を計画しております。また、製品の納品後もアップデートによる機能の追加、検査項目の拡充を積極的に進め、地域医療に貢献できるようにしてまいります。なお、機器の詳細につきましては、当社WEBページをご参照ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	278,480	127,619
売掛金	21,058	33,865
電子記録債権	21,670	1,815
商品及び製品	215,344	196,800
仕掛品	797,167	847,664
原材料及び貯蔵品	506,251	537,094
前渡金	8,677	1,065
未消費税等	13,270	9,574
その他	15,381	9,031
流動資産合計	1,877,301	1,764,531
固定資産		
有形固定資産		
建物	8,182	8,182
減価償却累計額	△8,182	△8,182
建物 (純額)	—	—
車両運搬具	8,885	8,885
減価償却累計額	△8,885	△8,885
車両運搬具 (純額)	—	—
工具、器具及び備品	181,952	181,952
減価償却累計額	△181,952	△181,952
工具、器具及び備品 (純額)	—	—
有形固定資産合計	—	—
投資その他の資産		
その他	27,827	27,636
貸倒引当金	△2,884	△2,884
投資その他の資産合計	24,943	24,752
固定資産合計	24,943	24,752
資産合計	1,902,244	1,789,284

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	21,750	11,074
1年内返済予定の長期借入金	32,064	32,064
短期借入金	157,030	—
未払金	75,020	43,736
未払法人税等	10,689	7,117
契約負債	45,696	34,052
製品保証引当金	300	552
その他	31,183	33,808
流動負債合計	373,734	162,405
固定負債		
長期借入金	169,030	144,982
リース債務	343	214
資産除去債務	6,418	6,489
固定負債合計	175,791	151,686
負債合計	549,526	314,092
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,210,563	1,427,232
資本剰余金	1,497,050	1,713,719
利益剰余金	△1,468,555	△1,822,606
株主資本合計	1,239,059	1,318,346
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	104,158	147,612
その他の包括利益累計額合計	104,158	147,612
新株予約権	9,500	9,234
純資産合計	1,352,717	1,475,192
負債純資産合計	1,902,244	1,789,284

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日)
売上高	138,881	263,602
売上原価	102,484	130,250
売上総利益	36,397	133,351
販売費及び一般管理費	550,278	508,185
営業損失(△)	△513,881	△374,833
営業外収益		
受取利息	77	40
為替差益	26,124	28,499
その他	4,623	1,894
営業外収益合計	30,825	30,435
営業外費用		
支払利息	2,566	4,701
支払手数料	—	944
その他	733	2,149
営業外費用合計	3,300	7,795
経常損失(△)	△486,356	△352,193
税金等調整前四半期純損失(△)	△486,356	△352,193
法人税、住民税及び事業税	1,857	1,857
法人税等調整額	—	—
法人税等合計	1,857	1,857
四半期純損失(△)	△488,214	△354,051
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△488,214	△354,051

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日)
四半期純損失 (△)	△488,214	△354,051
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	76,887	43,453
その他の包括利益合計	76,887	43,453
四半期包括利益	△411,327	△310,597
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△411,327	△310,597
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

当社グループは、前連結会計年度において半導体需要のダブつきによる工場稼働率の調整の影響を受け、売上・受注時期がずれ込み、売上高210,315千円にとどまり、営業損失693,502千円、親会社株主に帰属する当期純損失686,241千円を計上いたしました。

当第3四半期連結累計期間において、2022年8月から顕在化した民生向け半導体の在庫調整も2023年上半年期には一段落するものと予測されておりましたが、在庫調整は、大方の予想より長期化し、当第3四半期においても未だ、だぶつき感が残っており、設備投資は第4四半期以降となる見込みです。当第3四半期末現在においては、スマートフォンやPCなどの需要は少しずつ上向いておりますが、民生向け半導体の適正在庫と言われる3か月分を上回っており、一部「有期EL」関連を除き、未だに4ないし5か月分の在庫調整が進められていると言われております(WSTS、「世界半導体市場統計」より)。そのため、それら機器で使用される半導体の製造設備を中心に設備投資に慎重さがみられました。そのような中、当社グループといたしましては、2023年8月と9月でそれぞれ1件の受注を頂き、当社顧客の設備投資意欲は鈍いながらも徐々に上向きつつあるものと思われませんが、当第3四半期連結累計期間中の売上は、上述の半導体市場のダブつきの影響を受け、低調に推移いたしました。

以上より、当第3四半期連結累計期間の売上高は、263,602千円にとどまり、営業損失374,833千円となり、親会社株主に帰属する四半期純損失を354,051千円計上しております。

上記のとおり、継続的な営業損失が発生している状況にあり、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループはこうした状況を早期に解消又は改善すべく、以下の対応策を継続して実施しております。

事業施策

1. 中国国内での受注販売活動の促進

まず、上述いたしましたように2022年8月から顕在化していた民生向け半導体の在庫調整も2023年上半年中には一段落するものと予測されておりましたが、当第3四半期末現在においても、各社半導体在庫は適正とされる3か月を上回る在庫があり、各半導体製造工場の在庫抑制を目的とした生産調整がなされ新規設備投資は思わしくありません。特に民生機器の一部である、スマートフォンやPC、そしてIT情報端末機器などの半導体製品にだぶつき感が発生し、各半導体工場における在庫抑制を目的とした生産調整が続いております。しかしながら、半導体のデザインハウス及び大手OSAT(半導体の検査、組立を受託する専門工場)を中心に工場の稼働率は回復の兆しが見えており、当社においても、当第3四半期連結会計期間にてデザインハウス、OSATからそれぞれ受注を頂きました。

WSTS(世界半導体市場統計)の調査では、半導体製造各社による在庫調整プロセスは、確実に進行しているとされ、その調整プロセスは、2023年半ばから徐々に解消に向かい2024年前半にかけて終了、増産に向かうとの見通しが主流となっていると報告されております。他方、半導体の種類や用途、テクノロジーノード(technology node、半導体製造プロセスとその設計ルールのことを言います。)により、一部の半導体では需給の逼迫が継続しており、市場の二極化が見られる一面もあります。そのため、製造各社における新規設備投資は、出口を見据えながら慎重な姿勢を崩してはおりませんが、確実に過剰在庫は減っており、第4四半期以降は徐々に回復してくるものと考えております。また2024年を含む中長期的には、ChatGPTに代表される生成人工知能A.I. サーバー投資や、自動車の電動化の進展及び5G関連産業への投資需要が強くと見込まれており、市場は力強く成長するものと見られております(「Electronic Engineering Times」より)。

また、近年の半導体の複雑化や集積度向上(例、線幅4nmから2nm)は半導体の機能の増加を意味し、検査時間の伸長に繋がります。しかしながら、同時に量産性も要求されるため、半導体検査市場は、装置能力の向上に加えて装置台数の増加が期待されるであろうと考えられております。

当社グループが「主力装置」と位置付けるLCDドライバIC検査装置は、スマートフォンやPC等の情報端末の液晶パネルの駆動に使われる「ディスプレイドライバーIC」の検査に使用されております。また、それら情報端末には、「CMOSイメージセンサーIC」、「ロジックIC」など多種に渡る周辺半導体デバイスが使われております。現状足元では、上記のように半導体市場の足踏み状態が続いておりますが、中長期的には需要も戻り、大きな伸びが期待される分野です。

上述のような理由から当第3四半期連結会計 期間中での売上は低迷致しましたが、当社の主力検査装置

「WTS-577SR」につきましては、当第3四半期連結会計 期間において、新たに3社から新デバイス向けベンチマークの承認をいただくことができました。加えて当社の主力検査装置「WTS-577SR」につきましては、開発中である「WTS-577SX」のハイエンドリソースの一部の開発済みリソースをとりこむことで、日々進化する新デバイスに向けた検査の提供をお客様に行うことが可能となり、また同時にお客様の量産ラインでの高い評価をいただくことができました。

第4四半期以降の半導体市場は、上述した世界半導体市場統計(WSTS)や日本貿易振興機構(JETRO)等の予想では、民生向け半導体(スマートフォン、PC向け半導体等)を中心として、生産調整は、出口が見える状況にあり、

市況においても2024年にかけて徐々に回復すると報告されております。当社では、当第3四半期末現在においてもいまだ不足が叫ばれる産業用高速半導体を先行手配し、今期、来期における急な出荷要請にも耐え得る体制を準備しております。

新しい挑戦として、2023年9月より中国における営業戦略を見なおし、今まで代理店営業に頼っていた体制から直接営業を中心とした営業体制への変更を実施し、第4四半期から翌期に向けて営業活動を進めてまいります。営業体制の見直しを受けて、当社の中国製造子会社「偉恩測試技術(武漢)有限公司」(以下、「ウインテスト武漢」という。)は、営業人事再編並びに顧客アクセスなどの向上を目的として、事務所を蘇州に移転しました。

また、中国市場新戦略として、当社親会社「武漢精測電子集団有限公司」グループの子会社で、同じく半導体検査装置関連の事業を営む「上海精積微半導体技術有限公司」と、営業・技術方面で協力体制を取るべく準備を進めております。

ウインテスト武漢におきましては、大阪事業所とともにQA(品質保証)の体制を見直し、最終組立工程の製造品質の向上に取り組み、中国国内市場での信頼構築と市場への深耕を図ってまいります。

2. 技術開発の強化

先端ロジックI/O(820Mbps)を搭載する検査装置に関しては、第1四半期に前倒しで一部機能のリリースを行い、第2四半期に新リソースを搭載したWTS-577SRを出荷、その他の新リソースは、引き続き開発を継続しております。

次世代向け機能としてロジックパターンスピードが1,600Mbpsとなる高速リソースについて、第4四半期中に開発を終了する計画としたおりましたが、先端ドライバICなどの一部部材の入荷遅れなどを原因として、評価が伸びております。これら開発中(一部完了)の新リソースをフルに積んだ、「WTS-577SX」のお客様への提供は、社内での最終評価の終了次第、遅くとも2024年第1四半期となる予定です。更に次世代のフラッグシップ検査装置である「WTS-9000S」の開発に関しては、2024年8月に完成、リリースする計画であり、国内、台湾、中国顧客向けを想定した機能やGUIの開発を継続しており、搭載するソフトウェア環境などの使い勝手の向上も視野に入れ、市場への早期リリースができるように計画しております。

また、新たな収益の柱を構築するための成長戦略として、当社グループがこれまで培ってきた検査技術や画像処理技術、高精度センサー技術、データ解析技術を応用し、且つ、当社及びウインテスト武漢の技術陣に加え、現地有力企業より営業方面・技術方面での協力体制を構築する予定です。それにより、2025年までに、今後市場拡大が見込まれるシステムオンチップ(SoC)市場や汎用デジタル市場等の検査分野、そしてM&Aも計画し、日本市場においても注目を集めるパワーデバイス検査分野への進出を目指し、この度あらたにパワーデバイス検査装置メーカーとパワーリソース開発などで協力体制取ることとなり、新規市場への参入、対応可能検査範囲の拡充と展開を行い、収益基盤の拡充に取り組んでまいります。

3. 隣接領域の展開と製品化

検査装置向け工場FA化機器技術(「自重補償機構技術」)については、学校法人慶應義塾大学慶應義塾先端科学技術研究センターと共同開発を進めており、特許等の申請については、既にお知らせのとおり手続きは終了しております。当該技術は当社の検査装置とウエーハ搬送装置との間のドッキングアダプター(以下「ポゴタワー」という。)の着脱(約25kg~30kg)をオペレーター一人で簡単に安全に行うための補助アーム(以下「マニピュレータ」という。)です。当面の目標として、その搬送可能重量を50kg前後で製品化を行います。現在は、製品の製造準備に取り掛かっており、先端ロボット等の開発製造をロボット等製造専門事業者様と協議を開始いたしました。また当該技術は、「半導体製造工場内FA化システム」、「物流搬送システム」並びに「介護等」への応用が可能と考えております。

奈良県立大学と進めております脈波(BCG, ECG)を利用したヘルスケア管理システムは、同大学並びに株式会社TAOS研究所とアライアンスを組み、製品化を行いました。2023年3月9日に開示しました「IoTセンサーを活用したセルフヘルスケア機器の販売開始決定及び価格に関するお知らせ」に記載いたしましたとおり、2023年4月1日より一部のお客様を中心に試験販売を開始いたしました。なお、当該製品の製造に関しましては当社大阪事業所で製造を行っており、2023年9月から製造を開始、順次市場投入を計画しております。また、製品の納品後もアップデートによる機能の追加、検査項目の拡充を積極的に進め、地域医療に貢献できるようにしてまいります。なお、機器の詳細につきましては、当社WEBページをご参照ください。

財務施策

財務面については、財務基盤の安定化を図るために、2023年9月15日開催の取締役会において、楽言海外国際(香港)有限公司を割当予定先とする第三者割当による新規株式の発行を行うことを決議し、2023年10月19日に約4億円の資金調達を実施しました。

これにより、次世代検査装置の開発継続及び開発人員の強化資金、先端半導体向け検査市場への参入準備資金、

並びに運転資金を確保することができました。今後とも、更なる財務基盤の安定化のために、親会社「武漢精測電子集団有限公司」と諮りながら、同グループ及び金融機関からの借入並びに資本増強等による資金確保についての施策を今後とも継続して実施してまいります。

以上の施策をもって抜本的な改善をしていく予定でおりますが、アフターコロナ、テレワーク需要の減少などの影響で半導体市場は、在庫の積み上がりを嫌い、生産調整から設備投資の大幅な減退をうけ半導体市場は大きく低迷しております。当社がメイン市場とする海外の新規受注並びに受注済み検査装置の出荷、売上は、中国経済が上向くと見込まれる第4四半期以降となります。事業施策及び財務施策の実現可能性は市場の状況、需要動向等の今後の外部環境の影響を受けること、今後の資金調達についても確約されるものではないことから、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。

なお、当四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を当四半期連結財務諸表に反映しておりません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日)

当社は、当第3四半期連結累計期間に、第三者割当の方法による第11回新株予約権(行使価額修正条項付)の権利行使による新株発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ216,669千円増加し、当第3四半期連結会計期間末において資本金が1,427,232千円、資本剰余金が1,713,719千円となっております。

(会計方針の変更)

(時価の算定に関する会計基準の適用方針)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。

なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日)

「II 当第3四半期連結累計期間 (報告セグメントの変更等に関する事項)」に記載のとおりです。

II 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日)

当社グループは、「半導体検査装置事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(報告セグメントの変更等に関する事項)

当社グループは、従来報告セグメントの「半導体検査装置事業」及び報告セグメントに含まない「その他」の2つにセグメントを区分しておりましたが、第1四半期連結会計期間より「半導体検査装置事業」の単一セグメントに変更しております。

これは、前連結会計年度に「その他」の事業セグメントに含まれておりましたオーディオ事業を株式会社データゲート(大阪府大阪市北区)に事業譲渡を行ったことにより、「その他」に含まれていた事業がなくなったため、報告セグメントを「半導体検査装置事業」の単一セグメントとして管理することが適切と判断したためであります。

当社の報告セグメントは単一セグメントになることから、前第3四半期連結累計期間及び当第3四半期連結累計期間におけるセグメントの情報の記載を省略しております。

(重要な後発事象)

(第三者割当による新株式の発行等)

当社は、2023年9月15日開催の取締役会において、楽言海外国際(香港)有限公司(以下「楽言」といいます。)との間で楽言を割当予定先として第三者割当による新株式を発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)することについて決議いたしました。

新株引受契約は、2023年10月2日に締結し、払込は2023年10月19日に完了しております。

1. 本第三者割当増資の目的

第3四半期連結会計年度末における当社の状況としては、強固な収益基盤の確立が急務であると認識しております。そのため、短期的に収益基盤の確立を行うためには、既存事業の経営効率の改善に加え、次世代検査装置の開発を完了し収益の柱とすること、またSoCなど複合IC検査装置及びパワー半導体市場への参入、それに伴う技術者の採用等、事業規模の拡大を行うことが急務であると判断しました。そのため、事業の基盤形成を行うべく後述する資金使途における事業資金の確保のため、本第三者割当による資金調達を行うことといたしました。

2. 募集の概要

- (1) 払込期間 2023年10月2日～2023年11月30日
- (2) 発行新株式数 3,669,000株
- (3) 発行価額 1株につき109円
- (4) 資本組入額 1株につき54.5円
- (5) 資金調達の額 399,921,000円
- (6) 募集又は割当方法(割当予定先) 第三者割当の方法により、全株式を楽言に割り当てます。
- (7) その他 上記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件としております。

3. 本第三者割当増資の割当先の概要

- (1) 名称 楽言海外国際(香港)有限公司
- (2) 本店の所在地 香港金鐘金鐘道89號力寶中心第一座10樓1003室
- (3) 代表者の役職・氏名 Director 胡海勇
- (4) 事業内容 中国、韓国、日本における半導体検査装置関連製品の輸出入及び販売
- (5) 資本金 359百万円 (2023年7月31日現在)

4. 株式割当数及びその算定根拠

当社の資金需要、楽言との業務協力及び当社の親会社であります武漢精測電子集团股份有限公司の持分割合等を総合的に勘案し、協議・検討を行った結果、株式割当数は、3,669,000株が相当であると判断いたしました。

5. 資金使途

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 次世代先端システム(WTS-9000S)開発資金及びバリエーション展開費用	70	2023年10月～2024年8月
② 技術者増強に伴う人件費等(技術営業、開発技術者、アプリ、サポート開発人員)	100	2023年10月～2024年12月
③ Soc向け検査装置市場への参入のための準備費用	150	2023年12月～2024年12月
④ その他運転資金	72	2023年10月～2024年4月
計	392	

3. その他

継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、前連結会計年度において半導体需要のダブつきによる工場稼働率の調整の影響を受け、売上・受注時期がずれ込み、売上高210,315千円にとどまり、営業損失693,502千円、親会社株主に帰属する当期純損失686,241千円を計上いたしました。

当第3四半期連結累計期間において、2022年8月から顕在化した民生向け半導体の在庫調整も2023年上半期には一段落するものと予測されておりましたが、在庫調整は、大方の予想より長期化し、当第3四半期においても未だ、だぶつき感が残っており、設備投資は第4四半期以降となる見込みです。当第3四半期末現在においては、スマートフォンやPCなどの需要は少しずつ上向いておりますが、民生向け半導体の適正在庫と言われる3か月分を上回っており、一部「有期EL」関連を除き、未だに4ないし5か月分の在庫調整が進められていると言われております(WSTS、「世界半導体市場統計」より)。そのため、それら機器で使用される半導体の製造設備を中心に設備投資に慎重さがみられました。そのような中、当社グループといたしましては、2023年8月と9月でそれぞれ1件の受注を頂き、当社顧客の設備投資意欲は鈍いながらも徐々に上向きつつあるものと思われませんが、当第3四半期連結累計期間中の売上は、上述の半導体市場のだぶつきの影響を受け、低調に推移いたしました。

以上より、当第3四半期連結累計期間の売上高は、263,602千円にとどまり、営業損失374,833千円となり、親会社株主に帰属する四半期純損失を354,051千円計上しております。

上記のとおり、継続的な営業損失が発生している状況にあり、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループでは、こうした状況を早期に解消又は改善すべく対応策に取り組んでおりますが、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、継続企業の前提に関する事項及びその対応策に関しましては、「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(継続企業の前提に関する注記)」に記載しております。